

概 要

本概要旨在提供本文件所載資料的概述。由於本節為概要，故並未包含可能對閣下屬重要的所有資料，且其全部內容均受本文件全文的規限，並應與本文件全文一併閱讀。閣下在決定[編纂][編纂]前，應閱讀整份文件。

任何[編纂]均涉及風險。[編纂][編纂]的部分特定風險載於本文件「風險因素」一節。閣下在決定[編纂][編纂]前，應仔細閱讀該節。

概覽

我們是一家全球領先的合金軟磁粉末製品提供商。於往績記錄期間，我們的產品組合主要包括(i)合金軟磁粉芯，(ii)AI芯片電感，以及(iii)合金軟磁粉末。

合金軟磁粉芯是以合金軟磁粉末製成。客戶通常將其與銅繞組結合製成繞線功率電感，主要應用於電能變換。另一方面，我們的AI芯片電感是以合金軟磁粉末及導體經一體化成型工藝製成的可板載電感元件成品。其主要用於AI算力基礎設施應用的芯片級供電。

根據灼識諮詢的資料，我們是全球少數擁有涵蓋合金軟磁粉末、合金軟磁粉芯到AI芯片電感的垂直整合能力的企業之一。以2025年收入計，我們(i)在全球合金軟磁粉芯市場排名第一，市佔率為27.1%，並(ii)在全球AI芯片電感市場排名第五，市佔率為7.6%。我們的產品已進入全球領先的AI芯片公司及雲服務提供商的供應鏈。

我們的業務由對更高電能變換效率、更高功率密度、更佳瞬態響應及更強系統穩定性的長期需求所驅動。在碳中和倡議的背景下、以及AI算力基礎設施、電氣化與自動化的發展下，上述要求正變得日益重要。合金軟磁粉末、合金軟磁粉芯及AI芯片電感在電能變換與控制中發揮核心作用。其性能影響電力電子器件及相關設備的效率、體積、穩定性及可靠性。因此，對我們產品的需求受到多種下游應用的支持，而非受限於單一的技術週期。

多年來，我們已建立一個合金軟磁粉末技術平台，使我們能夠將材料技術及工藝訣竅應用於不同產品及應用領域。該平台以材料技術、預處理技術、成型技術及精密裝備技術為基礎。基於這些底層技術，我們發展了產品設計、產品升級及規模化生產能力。該等能力貫穿我們與客戶合作的全程，用以評估客戶需求並制定定製化解決方案。我們的現場應用工程師（「FAE」）自產品定義階段起便與客戶合作，且我們利用磁材數據庫及磁粉芯功率電感輔助設計軟件，將客戶的電源系統及應用需求轉化為材料成分及元件設計方案。

概 要

下圖載列我們合金軟磁粉末技術平台及主要應用場景的詳情：



附註：

(1) 我們正探索端側AI硬件的相關應用。

在該平台的支持下，我們已從合金軟磁粉末擴展至合金軟磁粉芯，並進一步擴展至AI芯片電感。我們的合金軟磁粉末按定製基礎向外供應。我們的合金軟磁粉芯涵蓋多個材料體系，旨在滿足跨越不同頻率、磁芯損耗、飽和性能水平、尺寸及可靠性標準的電能變換需求。我們亦解決了將合金軟磁材料應用於高頻半導體應用的技術挑戰，並開發出具備高效率、小體積、可靠性與功率能力的AI芯片電感。憑藉在合金軟磁材料的研究與開發（「研發」）、規模化生產及應用方面超過17年的經驗，我們相信我們已準備就緒，能夠把握下游應用持續演變所帶來的機遇。該等領域包括DDR內存、光模塊、AI PC及AI智能手機。

下圖載列我們業務亮點的進一步詳情：

市場地位	全球第一	全球第五	優質客戶基礎
	2025年合金軟磁粉芯收入 ⁽¹⁾	2025年AI芯片電感收入 ⁽¹⁾	3家全球五大被動元器件廠商 ⁽¹⁾ 3家全球五大模擬芯片廠商 ⁽¹⁾ 2家全球五大光伏逆變器廠商 ⁽¹⁾
	全球少數	全球首創	中國首批
研發能力	擁有涵蓋合金軟磁粉末、合金軟磁粉芯及AI芯片電感的垂直整合能力 ⁽¹⁾	高壓成型結合銅鐵共燒技術 ⁽¹⁾⁽²⁾	規模化生產氣霧化合金軟磁粉末 ⁽¹⁾⁽²⁾
	24.7%	42.0%	29.1%
	2023年至2025年 收入複合年增長率	2025年毛利率	2023年至2025年 淨利潤 複合年增長率
財務表現			

附註：

- (1) 根據灼識諮詢的資料。
(2) 請參閱「業務—研發—我們的技術」。

概 要

我們的業務模式及產品

我們設計、開發及銷售一系列合金軟磁粉末製品。於往績記錄期間，我們的產品組合包括(i)合金軟磁粉芯，一種用於電感的磁芯；(ii)AI芯片電感，即以合金軟磁粉末及導體經一體化成型工藝製成的可板載電感元件成品；(iii)合金軟磁粉末，為客戶指定應用開發的定製粉末；及(iv)其他，包括定製合金基電感。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 我們的產品」。

我們的優勢

我們相信以下優勢促成了我們的成功：(i)我們的合金軟磁材料技術及先發積累推動產品升級及應用拓展；(ii)體系化研發與工藝能力將材料專知轉化為產品性能；(iii)我們從材料到元件的垂直一體化能力支持產品質量、成本競爭力及高效的產品開發；(iv)規模化生產及質量控制能力支持向全球客戶穩定供應；(v)客戶群及技術協同支持業務持續增長；及(vi)經驗豐富的創始管理團隊與嚴謹的執行力支持我們的戰略發展。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 我們的優勢」。

我們的戰略

我們擬實施以下戰略：(i)透過強化產能及把握下游市場增長，擴大市場份額；(ii)持續加大研發投入，佈局先進材料技術及工藝；(iii)加強銷售及管理能力；及(iv)戰略整合補強業務能力。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 我們的戰略」。

銷售及經銷網絡

於往績記錄期間，我們絕大部分的銷售均直接向客戶作出。因為我們的產品屬技術性工業品且具有較高定製特性，涉及定製規格及應用特定要求，我們採用直銷作為主要銷售模式。該等直銷主要包括來自被動元件製造商、外包半導體封測(OSAT)提供商、集成電路(IC)製造商以及光伏逆變器製造商的訂單。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 銷售及營銷 — 我們的銷售網絡」。

概 要

我們的生產

截至2026年3月31日，我們在中國內地擁有兩處生產基地。下表載列於所示期間按主要產品類型劃分的設計產能、實際產量及利用率的詳情：

	截至12月31日止年度			截至3月31日 止三個月
	2023年	2024年	2025年	2026年
合金軟磁粉芯				
設計產能 ⁽¹⁾ (噸)	36,000	42,755	50,586	11,762
實際產量(噸)	32,326	38,052	41,416	9,505
利用率 ⁽²⁾ (%)	89.8	89.0	81.9	80.8
AI芯片電感				
設計產能 ⁽¹⁾ (千件)	29,791	109,752	119,618	54,363
實際產量(千件)	26,240	98,834	104,744	41,058
利用率 ⁽²⁾ (%)	88.1	90.1	87.6	75.5 ⁽³⁾
合金軟磁粉末				
設計產能 ⁽¹⁾⁽⁴⁾ (噸)	976	1,708	2,593	604
實際產量(噸)	806	1,427	2,149	416
利用率 ⁽²⁾ (%)	82.6	83.5	82.9	68.9 ⁽⁵⁾

附註：

- (1) 設計產能基於我們的已投產生產線每日兩班製運行(每班11小時)，每年運行305天及截至2026年3月31日止3個月運行71天的總生產速率。
- (2) 利用率等於實際產量除以設計產能。
- (3) 我們於截至2026年3月31日止三個月的AI芯片電感產能利用率相對較低，主要因為我們持續擴大產能以滿足日益增長的下游市場需求，而該等新增產能於截至2026年3月31日止三個月仍處於產能爬坡階段。
- (4) 我們合金軟磁粉末的產能乃基於銷售予外部客戶的定製合金軟磁粉末的產能計算，並不包括在生產我們的合金軟磁粉芯及AI芯片電感過程中內部生產及消耗的合金軟磁粉末，因該等內部使用的粉末屬於相關產品生產過程的一部分，並未被視為獨立產品計算在內。
- (5) 我們於截至2026年3月31日止三個月的合金軟磁粉末產能利用率相對較低，主要歸因於下游市場需求的波動。

有關進一步詳情，請參閱「業務 — 生產」。

客戶及供應商

於2023年、2024年及2025年以及截至2026年3月31日止三個月，我們各年度／期間的五大客戶分別合共產生人民幣510.8百萬元、人民幣784.6百萬元、人民幣829.2百萬元及人民幣232.8百萬元的收入，分別佔我們總收入的44.1%、47.2%、46.1%及47.5%。於往績記錄期間各期間，來自我們最大客戶的收入分別佔我們總收入的17.8%、13.5%、13.5%及17.8%。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 我們的客戶」。

概 要

於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，向我們各年度／期間的五大供應商的採購額分別為人民幣272.0百萬元、人民幣285.2百萬元、人民幣326.2百萬元及人民幣101.2百萬元，分別佔我們總採購額的51.7%、47.2%、44.4%及41.6%。此外，於往績記錄期間各期間，向我們的最大供應商的採購額分別佔我們的總採購額的21.6%、20.3%、19.1%及14.7%。有關進一步詳情，請參閱「業務 — 我們的供應商」。

競爭格局

我們所處的市場競爭激烈且發展迅速，並與全球及國內的合金軟磁粉末、合金軟磁粉芯及電感製造商展開競爭。我們行業的競爭主要體現在材料技術、產品性能、研發與工藝能力、生產規模、質量穩定性、成本競爭力、客戶認可度以及保障穩定供應的能力等方面。我們認為，我們在合金軟磁粉末、合金軟磁粉芯和AI芯片電感領域的垂直整合能力，加之我們的產品組合及積累的材料技術，使我們在競爭環境中佔據有利地位。更多詳情，請參閱「行業概覽」。

風險因素

我們的業務及[編纂]涉及「風險因素」一節所載的若干風險。我們面臨的部分風險包括：(i)我們的業務受到經營所處行業宏觀經濟波動的影響；(ii)我們過往的增長未必能反映未來的財務業績，且我們未必能夠有效實施未來的增長計劃；(iii)對我們產品的需求取決於我們所服務的終端市場的需求，倘該等需求出現放緩或下降，可能會對我們的業務造成重大不利影響；(iv)競爭及定價壓力是影響我們利潤率及財務表現的重要因素；及(v)我們的生產基地運營倘受到任何干擾，或無法提升我們的生產能力，均可能直接影響我們的財務狀況及經營業績。有關進一步詳情，請參閱「風險因素」。

歷史及財務資料概要

我們的歷史財務資料乃根據《國際財務報告準則》（「國際財務報告準則」）編製。下表呈列我們於所示期間或日期的歷史財務資料，該等資料摘錄自本文件附錄一會計師報告所載的我們的歷史財務資料。歷史財務數據概要應與本文件附錄一會計師報告所載的歷史財務資料一併閱讀，並受該等歷史財務資料的全文規限。

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

綜合損益及其他全面收益表概要

下表載列我們於所示期間的綜合損益及其他全面收益表概要：

	截至12月31日止年度						截至3月31日止三個月			
	2023年		2024年		2025年		2025年		2026年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元 (未經審計)	%	人民幣千元 (未經審計)	%
收入	1,158,520	100.0	1,662,941	100.0	1,802,237	100.0	383,308	100.0	489,593	100.0
銷售成本	(699,641)	(60.4)	(986,192)	(59.3)	(1,045,698)	(58.0)	(238,881)	(62.3)	(307,953)	(62.9)
毛利	458,879	39.6	676,749	40.7	756,539	42.0	144,427	37.7	181,640	37.1
其他收入、收益及虧損	23,569	2.0	17,872	1.1	15,380	0.9	2,470	0.6	(3,389)	(0.7)
銷售及經銷開支	(20,764)	(1.8)	(26,606)	(1.6)	(24,967)	(1.4)	(5,683)	(1.5)	(6,395)	(1.3)
行政開支	(77,837)	(6.7)	(99,453)	(6.0)	(95,867)	(5.3)	(18,636)	(4.9)	(24,830)	(5.1)
研發開支	(74,713)	(6.4)	(117,137)	(7.0)	(151,556)	(8.4)	(31,269)	(8.2)	(42,890)	(8.8)
金融資產減值虧損	(765)	(0.1)	(14,532)	(0.9)	(187)	(0.0)	129	0.0	1,219	0.2
經營利潤	308,369	26.6	436,893	26.3	499,342	27.7	91,438	23.9	105,355	21.5
財務成本	(17,625)	(1.5)	(16,473)	(1.0)	(19,411)	(1.1)	(3,797)	(1.0)	(4,066)	(0.8)
應佔聯營公司損益	—	—	—	—	44	0.0	—	—	83	0.0
除稅前利潤	290,744	25.1	420,420	25.3	479,975	26.6	87,641	22.9	101,372	20.7
所得稅	(35,148)	(3.0)	(46,642)	(2.8)	(53,851)	(3.0)	(14,214)	(3.7)	(12,853)	(2.6)
年內／期內利潤	255,596	22.1	373,778	22.5	426,124	23.6	73,427	19.2	88,519	18.1
年內／期內其他全面收益	—	—	—	—	26	0.0	—	—	(624)	(0.1)
年內／期內全面收益總額	255,596	22.1	373,778	22.5	426,150	23.6	73,427	19.2	87,895	18.0

我們的年內利潤由2023年的人民幣255.6百萬元增加至2024年的人民幣373.8百萬元，並進一步增加至2025年的人民幣426.1百萬元；而我們的期內利潤由截至2025年3月31日止三個月的人民幣73.4百萬元增加至截至2026年3月31日止三個月的人民幣88.5百萬元，主要由於客戶對合金軟磁粉芯及AI芯片電感的需求增加帶動收入增加所致。

請參閱「財務資料 — 綜合損益及其他全面收益表」。

概 要

綜合財務狀況表概要

下表載列我們於所示日期的綜合財務狀況表概要：

	截至12月31日			截至3月31日
	2023年	2024年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審計)
流動資產總額	1,193,453	1,412,542	1,956,693	1,973,154
非流動資產總額	1,318,269	1,667,367	2,014,637	2,097,821
資產總額	2,511,722	3,079,909	3,971,330	4,070,975
流動負債總額	(277,855)	(271,032)	(441,922)	(467,930)
非流動負債總額	(326,493)	(488,351)	(471,362)	(474,549)
負債總額	(604,348)	(759,383)	(913,284)	(942,479)
流動資產淨額	915,598	1,141,510	1,514,771	1,505,224
資產淨值	1,907,374	2,320,526	3,058,046	3,128,496

請參閱「財務資料 — 選定財務狀況表項目」。

綜合現金流量表概要

下表載列我們於所示期間的綜合現金流量表概要：

	截至12月31日止年度			截至3月31日止三個月	
	2023年	2024年	2025年	2025年	2026年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元 (未經審計)	人民幣千元 (未經審計)
經營活動所得現金淨額	161,346	112,425	347,435	118,430	95,065
投資活動所用現金淨額	(39,742)	(165,324)	(371,120)	(305,019)	(55,924)
融資活動(所用)／所得現金淨額	(78,886)	13,383	319,228	294,810	(25,410)
現金及現金等價物增加／(減少)淨額	42,718	(39,516)	295,543	108,221	13,731
匯率變動影響	2,025	2,671	(4,716)	142	(5,343)
年初／期初現金及現金等價物	136,308	181,051	144,206	144,206	435,033
年末／期末現金及現金等價物	181,051	144,206	435,033	252,569	443,421

概 要

請參閱「財務資料 — 流動資金及資本資源」。

主要財務比率

下表載列我們截至所示日期或所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日止年度／截至該日			截至3月31日 止三個月／ 截至該日
	2023年	2024年	2025年	2026年
毛利率 ⁽¹⁾ (%)	39.6	40.7	42.0	37.1
淨利潤率 ⁽²⁾ (%)	22.1	22.5	23.6	18.1
股本回報率 ⁽³⁾ (%)	14.5	17.7	15.8	不適用
總資產回報率 ⁽⁴⁾ (%)	10.7	13.4	12.1	不適用
流動比率 ⁽⁵⁾ (倍)	4.3	5.2	4.4	4.2

附註：

- (1) 毛利率按年內／期內毛利除以同一年內／期內總收入再乘以100%計算。
- (2) 淨利潤率按年內／期內淨利潤除以同一年內／期內總收入再乘以100%計算。
- (3) 股本回報率按相應年度淨利潤除以期初及期末股東權益總額的算術平均值再乘以100%計算。截至2026年3月31日止三個月的股本回報率未納入作比較用途，乃由於我們認為將截至2026年3月31日止三個月的比率與完整財政年度末的比率進行比較並無意義。
- (4) 總資產回報率按相應年度淨利潤除以期初及期末總資產的算術平均值再乘以100%計算。截至2026年3月31日止三個月的總資產回報率未納入作比較用途，乃由於我們認為將截至2026年3月31日止三個月的比率與完整財政年度末的比率進行比較並無意義。
- (5) 流動比率按相應年度／期間末流動資產除以截至同日流動負債計算。

我們的單一最大股東集團

於最後實際可行日期，我們的執行董事兼董事長杜先生(i)直接擁有本公司8,308,510股A股股份的權益，佔本公司表決權約2.04%；及(ii)透過由杜先生控股54.00%的摩碼投資間接擁有本公司91,261,463股A股股份的權益，佔本公司表決權約22.44%。因此，杜先生於本公司99,569,973股A股股份中擁有權益，並有權行使本公司約24.49%的表決權。故此，杜先生及摩碼投資被視為單一最大股東集團。

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使，且於最後實際可行日期至[編纂]期間本公司已發行股本並無其他變動)，杜先生及摩碼投資將有權於本公司股東大會上行使約[編纂]%的表決權，並將繼續為單一最大股東集團。於[編纂]後，本公司將並無任何上市規則所界定之控股股東。

概 要

我們於深圳證券交易所的上市情況

自2019年12月起，我們的A股已於深圳證券交易所上市。我們的董事確認，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無任何重大違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情形。據我們的董事所知，概無有關我們於深圳證券交易所的合規記錄的重大事宜須提請聯交所或[編纂]的[編纂]垂注。根據深圳證券交易所網站的公告及公開領域可得的資料，我們的中國法律顧問認為，(i)於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團概無任何重大違反深圳證券交易所適用規則及其他適用中國證券法律法規的情形；及(ii)於整個往績記錄期間及直至最後實際可行日期，本公司已在所有重大方面遵守適用於A股上市的所有法律法規。

根據獨家保薦人進行的獨立盡職審查及上文所載我們的中國法律顧問的意見，獨家保薦人並未注意到任何事宜會使其對我們的董事有關本公司在深圳證券交易所的合規記錄所作出的確認產生異議。

[編纂]用途

在假設[編纂]未獲行使且假設[編纂]為每股[編纂]港元(即[編纂]範圍的中位數)的情況下，經扣除我們就[編纂]已付及應付的[編纂]、費用及估計開支後，我們估計將自[編纂]收取的[編纂]約為[編纂]港元。我們擬將自[編纂]收取的[編纂]用於以下用途，但會視乎我們不斷發展的業務需求及變化的市場狀況而有所變動：(i)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於擴建及升級我們的AI芯片電感產能；(ii)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於擴建及升級我們的合金軟磁粉芯產能；(iii)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於戰略合作夥伴關係、投資及收購；及(iv)[編纂]的約[編纂]%，即[編纂]港元，將用於營運資金及一般企業用途。

請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

股息及股息政策

根據本公司的公司章程，本公司已採納股息分派政策，據此，本公司一般考慮每年派發股息，並可在股東批准的情況下考慮派發中期股息。於2023年、2024年、2025年及截至2026年3月31日止三個月，分別宣派及派付現金股息人民幣22.1百萬元、人民幣40.0百萬元、人民幣57.8百萬元及零。於2026年5月15日，宣派現金股息人民幣58.0百萬元，後已悉數派付。有關更多詳情，請參閱附錄一所載會計師報告附註34。

公司章程訂立指導原則，即本公司應實施持續穩定的利潤分配政策。本公司的利潤分配應著重向投資者提供合理回報、保障投資者的合法權益，並兼顧本公司的可持續發展。然而，本公司並無固定的股息派付比率。任何宣派或派付股息均須由董事會酌情決定並獲股東批准，並需考慮本公司的經營業績、財務狀況、經營及資本需求及其認為相關的其他因素。對於未來任何股息的時間、金額或形式，概不保證。

概 要

法律程序及合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾捲入任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規性產生重大不利影響的實際或未決的法律、仲裁或行政程序（包括任何破產或接管程序）。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾捲入任何不論個別或合計，導致重大罰款、執法行動或其他重大處罰，而可能對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響的重大不合規事件。我們的董事認為，於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們在所有重大方面均已遵守我們營運所在司法權區的所有相關法律及法規。

近期發展

無重大不利變動

我們的董事確認，截至本文件日期，自2026年3月31日（即我們最近期報告的財務報表期末）起，我們的財務或交易狀況、債務、抵押、或有負債、擔保或前景並無發生重大不利變動，且自2026年3月31日起，並無發生任何將對本文件附錄一會計師報告所示資料造成重大影響的事件。

[編纂]

我們的[編纂]主要包括(i)[編纂]相關開支，例如[編纂]費用及[編纂]，以及(ii)非[編纂]相關開支，包括就[編纂]及[編纂]提供服務而向我們的法律顧問及申報會計師支付的專業費用，以及其他費用及開支。假設悉數支付酌情激勵費用，[編纂]的估計[編纂]總額（基於[編纂]的中位數且假設[編纂]未獲行使）約為[編纂]港元，約佔我們[編纂]總額的[編纂]%。在該等估計[編纂]總額中，我們預期支付[編纂]相關開支[編纂]港元、我們的法律顧問及申報會計師的專業費用[編纂]港元以及其他費用及開支[編纂]港元。我們[編纂]的估計金額[編纂]港元預期將通過損益表支銷，其餘金額[編纂]港元預期將於[編纂]時直接確認為權益扣減。

[編纂]

本文件為草擬本。其所載資料並不完整及可作更改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

概 要

[編纂]